



推奨基板取付け寸法 (非累積公差)
 RECOMMEND PC BOARD HOLE (NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
 PC BOARD THICKNESS: 1.6 ± 0.1
 基板厚: 1.6 ± 0.1

NOTES

- 1. MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, UL94V-0
 CONTACT: COPPER ALLOY
 RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- △2. FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
- △3. FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
- △4. FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- △5. FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- △6. FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

- 1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性樹脂, UL94V-0
 コンタクト: 銅合金
 リテンションレグ: 銅合金
- △2. めっき: コンタクト接触部: ニッケル下地の上に金めっき 0.38 μm MIN
- △3. めっき: コンタクト接触部: ニッケル下地の上に金めっき 0.76 μm MIN
- △4. めっき: コンタクト: 全面Ni下地 接触部: 2.0 μm MIN スズめっき
- △5. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部: ニッケル下地の上に半田めっき
- △6. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部: ニッケル下地の上にスズめっき

△6	△4	-5
△6	△3	-3
△6	△2	316517-2
FINISH		型番 PART NUMBER

Copyright ©1995 年		Copyright ©1995 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
B REVISED (FJD0-0039-03)		TS J.M. 10/25		名称 (NAME) DYNAMIC (D-3500) 20 POS. V HDR. ASS'Y	
A REVISED (FJD0-0114-03)		TS SM 10/25		一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm以下: ±0.35 10mm超 3mm以下: ±0.4 30mm超 100mm以下: ±0.45 角度: ±3'	
O RELEASED FJ00-3261-95		NM Y.I. 10/24		尺貫 (SCALE) 2/1	
LTR 変更 (REVISION RECORD)		DR CHK DATE		番号 (No.) C-316517	
		CHK. Y. ISHIKAWA		REV. B	
				SHEET 1 of 1	

NUMBER 316517
 METRIC
 PROJ NO. 395-623
 単位: 寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT
 PRINT DIST
 AMP-J
 REV. 10/93